

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于江苏艾森半导体材料股份有限公司**  
**2024 年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：艾森股份
保荐代表人姓名：刘伟	联系电话：021-38966588
保荐代表人姓名：张帅	联系电话：021-38966588

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，对艾森股份进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

### **一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况**

2024 年 12 月，公司在对募集资金存放与使用情况进行自查及保荐人定期核查时发现，由于相关工作人员对相关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度关于募集资金规范使用的要求认识不足，导致 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 26 日期间公司存在闲置募集资金管理超出董事会决议有效期的情况。

上述期间公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金未超过公司第三届董事会第三次会议审议的相关额度，且均为购买安全性高、流动性好的保本型产品或以通知存款、协定存款形式存放，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司于2024年12月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，对2024年12月9日至2024年12月26日期间公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的事项进行补充审议并同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 二、重大风险事项

### （一）核心竞争力风险

#### 1、市场竞争风险

随着下游封测厂商持续加大投入先进封装技术，先进封装用电子化学品面临着良好的发展机遇。公司推出了多款先进封装用光刻胶及配套试剂产品。先进封装领域具有较好的市场前景，其他内资厂商持续增加研发投入、扩建产能或推出新产品参与市场竞争。如公司未能持续更新技术及开发产品，降低产品成本，则公司将面临不断加大竞争压力，并降低公司光刻胶配套试剂的收入增速或市场份额。下游封测厂商对光刻胶的可靠性和稳定性要求极高，更换供应商难度较大。公司与国际巨头争夺高端市场，公司面临无法抢占其市场份额的竞争风险。综上，如果公司不能根据市场需求持续更新技术和开发产品，保持产品和技术竞争力，公司可能无法与国内外企业进行有效竞争，从而对公司的市场份额、市场地位、经营业绩造成不利影响。

#### 2、自研光刻胶产品产业化风险

公司自研光刻胶产品主要包括先进封装用负性光刻胶、晶圆制造PSPI光刻胶、OLED阵列制造正性光刻胶、晶圆制造i线正性光刻胶、ICA化学放大光刻胶、KrF光刻胶等。公司主要自研光刻胶产品虽均已通过行业主要客户的认证并进入正式供货阶段，但尚未能实现对下游客户在用产品的完全替代，处于产业化前期，对收入贡献较低。由于下游客户对光刻胶的产品性能、品质及稳定性要求严格，相关产品认证时间及量产周期均较长，且影响因素众多，如受产品稳定性不足、客户推迟上线安排、下游市场需求变动等因素影响，公司自研光刻胶产品无法实现大规模产业化，将对公司未来发展带来不利影响。

## **(二) 经营风险**

### **1、毛利率下降的风险**

公司产品包括电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂以及电镀配套材料三大类别，不同类别产品的毛利率水平主要受所处行业情况、市场供求关系、产品技术特点、产品更新迭代、公司销售及市场策略、原材料价格等因素综合影响而有所差异。若原材料价格出现回升，或公司未能根据市场变化及时进行产品技术升级，产品技术缺乏先进性，公司市场推广未达预期，造成高毛利产品销售占比下降，可能导致公司毛利率水平下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。

### **2、经营性现金流量为负的风险**

公司经营性现金流量持续为负，主要原因系公司下游客户部分采取票据结算，而上游供应商接受票据结算的比例较低，为提高资金周转效率，公司将收到的部分票据进行贴现，票据贴现的资金流入计入“筹资活动产生的现金流量-取得借款收到的现金”所致。若公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，票据收款占比提高，将会给公司营运管理带来一定压力。

### **3、原材料价格波动的风险**

公司原材料主要包括各种溶剂类和固体类的化工原料，以及以锡材(锭)为主的金属材料；上述材料作为大宗工业原材料，其价格易受国际原油价格或国际金属价格的波动影响。

## **(三) 行业风险**

### **1、半导体行业周期变化风险**

目前公司产品主要应用于集成电路、半导体显示等半导体产业。近年来，受益于下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求的持续增长，全球半导体特别是集成电路产业实现了快速发展。中国集成电路产业在下游市场的推动以及政府与资本市场的刺激下，获得了强大的发展动力。由于全球半导体行业景气周期与宏观经济、下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果未来半导体行业市场需求因宏观经济或行业环境等原因出现下滑，将

对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。如半导体行业下行周期持续，或公司不能通过开发新产品、开拓新客户等方式进行有效应对，将可能对公司经营业绩造成不利影响。

## 2、细分行业市场规模较小的风险

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。电子化学品具有品类多，应用领域细分等特点，公司主要产品为电镀液及配套试剂，主要应用于传统封装领域。公司的市场占有率较高，增长空间有限，存在细分行业市场规模较小的风险。虽然公司立足于传统封装领域电镀液及配套试剂，沿着产业链向其他应用领域发展，已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领域的电镀工艺环节，若未来上述细分行业市场容量增长不及预期，将对公司经营状况和业绩情况产生不利影响。

### （四）募集资金投资项目新增产能的消化风险

未来如果市场情况发生不可预见的变化，或者出现公司不能有效开拓新市场等其他对产品销售不利的因素，公司募投项目达产后可能无法实现预期销售，将存在新增产能难以消化，募集资金投资项目无法实现预期盈利的风险。

## 三、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

## 四、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年度，公司主要财务数据及指标如下表所示：

单位：万元

主要财务数据	2024年度/2024年12月31日	2023年度/2023年12月31日	增减幅度
营业收入	43,218.84	36,003.93	20.04%
归属于上市公司股东的净利润	3,347.75	3,265.73	2.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,439.14	2,716.47	-10.21%
经营活动产生的现金流量净额	-2,471.86	-8,453.18	不适用
归属于上市公司股东的净资产	97,397.15	101,624.69	-4.16%

主要财务数据	2024年度/2024年12月31日	2023年度/2023年12月31日	增减幅度
总资产	124,410.57	127,988.91	-2.80%
主要财务指标	2023年度	2022年度	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.38	0.49	-22.45%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.49	-22.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.41	31.71%
加权平均净资产收益率（%）	3.29	7.17	减少 3.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.39	5.96	减少 3.57 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	10.62	9.08	增加 1.54 个百分点

上述主要财务数据及财务指标的变动原因如下：

1、2024年度，公司实现营业收入43,218.84万元，同比增长20.04%，主要原因系公司在先进封装领域表现出良好的增长趋势，先进封装板块收入同比增长42.24%，带动整体营收实现增长。

2、2024年度，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长2.51%，净利润增长幅度小于营业收入增长幅度，主要原因系公司持续加大在先进封装及晶圆制造领域的研发投入，研发费用增长较多所致。2024年度，公司研发费用4,590.17万元，同比增长40.42%。

3、2024年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降10.21%，主要原因系2024年度公司使用暂时闲置的资金购买结构性存款金额较高，收益计入非经常性损益所致。

4、2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,471.86万元，净流出较上年同期减少70.76%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因系公司票据收款贴现的现金流入计入“筹资活动产生的现金流量-取得借款收到的现金”所致。报告期内，公司经营活动现金净流出较上年同期大幅减少，主要原因系公司使用票据进行贴现金额减少，本期销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于本期购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度。

5、2024年末，公司归属于上市公司股东的净资产同比降低4.16%，总资产同比降低2.80%，基本保持稳定。

## 五、核心竞争力的变化情况

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用技术等核心技术，公司能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案（Turnkey），满足客户对电子化学品的特定功能性要求。

在电镀液及配套试剂领域，经过十几年的技术沉淀与经验积累，公司凭借关键核心技术，产品性能整体已与国际竞争对手相当，部分指标甚至超越国外竞品。目前，公司电镀液产品已构建起丰富且极具竞争力的产品矩阵，在传统封装和先进封装领域均实现了全品类覆盖，并成功实现高端应用领域的市场突破。在先进封装领域，公司先进封装用电镀液及添加剂已实现多款产品量产供应，广泛应用于Bumping和RDL等工艺。例如，电镀铜基液（高纯硫酸铜）已在华天科技、通富微电实现稳定供应，电镀锡银添加剂已通过长电科技的严格认证并取得小批量订单；先进封装用电镀铜添加剂正处于批次稳定性验证阶段。在晶圆制造领域，公司28nm大马士革铜互连工艺镀铜添加剂产品目前处于产品认证后期阶段；5-14nm先进制程的超高纯硫酸钴基液和添加剂在客户端测试进展顺利，晶圆制造铜制程用清洗液已进入量产放大阶段。公司在电镀液产品的技术先进性和市场应用拓展方面处于行业第一方阵。

在光刻胶及配套试剂方面，公司以光刻胶配套试剂为切入点，成功实现附着剂、促进剂、显影液、去除剂、蚀刻液等产品在下游封装厂商的规模化供应。同时，公司积极开展光刻胶的研发，以先进封装负性光刻胶、OLED阵列制造用光刻胶以及晶圆用PSPI等特色工艺光刻胶为突破口，覆盖晶圆制造、先进封装及显示面板等应用领域，成功打破国外垄断，并逐步向先进制程延伸。目前，公司自研先进封装用g/i线负性光刻胶、晶圆制造i线正性光刻胶均已实现批量供应。公司自主研发的正性PSPI光刻胶成功获得主流晶圆厂首个国产化订单，打破了美日企业

在该领域的长期技术垄断，成为国内首家实现该材料进口替代的企业。自2024年第三季度开始逐步量产，预计2025年将逐步实现规模化出货。公司晶圆ICA化学放大光刻胶，在客户端验证测试顺利，部分指标优于国际厂商对标产品，具备良好的市场应用前景。

综上，2024年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

## **六、研发支出变化及研发进展**

半导体行业属于典型的技术密集型产业，技术创新与产品升级换代速度极快。公司始终紧跟前沿科技发展趋势，全力推进国产化产业链建设，围绕自身核心技术，基于产业发展动态及下游客户的多样化需求，在不断提升技术与产品能力的同时积极拓宽产品品类，致力于为客户提供更具竞争力的产品组合及整体解决方案。报告期内，公司技术成果转化能力和产品开发效率显著提高，新产品开发能力和技术竞争实力持续增强。

2024年度，公司研发投入4,590.17万元，同比增长40.42%；研发投入占营业收入的比例为10.62%，同比提高1.54个百分点。

2024年度，公司各项在研项目均有序推进，部分项目取得阶段性成果。2024年度，公司新增申请发明专利19项，新获授权发明专利2项，研发成果持续得到体现。

## **七、新增业务进展是否与前期信息披露一致**

不适用。

## **八、募集资金的使用情况及是否合规**

经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为28.03

元/股。本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 39,435.63 万元，募集资金余额为 5,429.12 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为 10,200.00 万元。2024 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	61,759.44
减：保荐及承销费用	4,627.89
募集资金实际到账金额	57,131.54
减：募投项目投入	15,071.14
支付发行费用	2,070.60
以闲置募集资金购买理财产品	45,100.00
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	24,975.72
募集资金专项账户手续费支出	0.13
注销募集账户利息余额转出	0.01
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	34,900.00
募集资金理财产品利息收益	429.36
募集资金专项账户存款利息收入	185.82
募集资金专项账户余额	5,429.12

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有 3 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账户	余额	备注
交通银行昆山分行	391064700013000424409	601.24	活期存款
	391899999603000019728	2,000.00	7天通知存款

苏州银行昆山支行	51433700001579	1,748.74	活期存款
昆山农商行中华园支行	2010020247364	1,079.14	活期存款
合计	-	5,429.12	-

2024年12月9日至2024年12月26日期间，公司存在闲置募集资金管理超出董事会决议有效期的情况。公司已及时整改并补充履行审议程序。除上述情况外，公司不存在违规使用募集资金的情形。

公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

## 九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务/身份	直接持股数(万股)	间接持股数(万股)	合计持股数(万股)	合计持股比例	2024年度的质押、冻结及减持情况
1	张兵	董事长/实际控制人	1,903.1621	222.4387	2,125.6008	24.12%	无
2	蔡卡敦	实际控制人	684.7826	-	684.7826	7.77%	无
3	向文胜	董事、总经理	-	128.7747	128.7747	1.46%	无
4	陈小华	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	53.3597	56.9170	110.2767	1.25%	无
5	杨一伍	董事	88.9328	58.6957	147.6285	1.68%	无
6	孙清清	独立董事	-	-	-	-	-
7	黄晓刚	独立董事	-	-	-	-	-
8	李挺	独立董事	-	-	-	-	-
9	孙杨(离)	董事	-	-	-	-	-

序号	姓名	职务/身份	直接持股数(万股)	间接持股数(万股)	合计持股数(万股)	合计持股比例	2024年度的质押、冻结及减持情况
	任)						
10	俞信华 (离任)	董事	-	-	-	-	-
11	秦舒(离任)	独立董事	-	-	-	-	-
12	朱雪珍 (离任)	独立董事	-	-	-	-	-
13	程瑛	监事会主席	-	-	-	-	-
14	沈鑫	监事	-	-	-	-	-
15	熊秋丽	职工代表监事	-	-	-	-	-
16	庄建华 (离任)	监事	163.6364	-	163.6364	1.86%	无
17	赵建龙	副总经理	62.2530	17.7866	80.0396	0.91%	无
18	谢立洋	副总经理	-	46.2451	46.2451	0.52%	无
19	吕敏	财务总监	-	-	-	-	-

2024年度，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

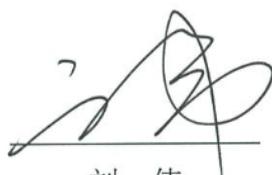
## 十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

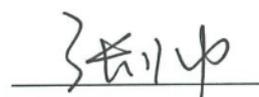
截至2024年12月31日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：

  
刘 伟

  
张 帅

华泰联合证券有限责任公司

